



2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年5月15日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
定時株主総会開催予定日 2024年6月27日 配当支払開始予定日 2024年6月28日
有価証券報告書提出予定日 2024年6月28日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨)

1. 2024年3月期の連結業績（2023年4月1日～2024年3月31日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期	222,430	5.5	24,872	△29.0	26,537	△37.5	15,154	△49.0
2023年3月期	210,810	57.5	35,042	55.1	42,448	63.3	29,702	11.4

(注) 包括利益 2024年3月期 33,699百万円 (△13.3%) 2023年3月期 38,847百万円 (△3.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2024年3月期	322.65	291.99	7.8	5.8	11.2
2023年3月期	644.81	633.15	18.9	12.6	16.6

(参考) 持分法投資損益 2024年3月期 △3,742百万円 2023年3月期 △610百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期	510,026	278,166	40.1	4,348.01
2023年3月期	410,648	249,656	44.7	3,916.07

(参考) 自己資本 2024年3月期 204,409百万円 2023年3月期 183,729百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年3月期	28,720	△92,400	60,419	96,806
2023年3月期	43,024	△68,760	68,718	95,905

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2023年3月期	—	50.00	—	55.00	105.00	4,922	16.3	3.1
2024年3月期	—	50.00	—	50.00	100.00	4,699	31.0	2.4
2025年3月期(予想)	—	50.00	—	50.00	100.00		29.4	

3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	110,000	4.3	12,500	△4.1	12,500	△17.9	7,500	△10.6	159.53
通期	235,000	5.7	26,000	4.5	26,000	△2.0	16,000	5.6	340.34

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
- ② ①以外の会計方針の変更： 無
- ③ 会計上の見積りの変更： 無
- ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期	47,111,567株	2023年3月期	47,011,067株
② 期末自己株式数	2024年3月期	99,365株	2023年3月期	94,305株
③ 期中平均株式数	2024年3月期	46,968,690株	2023年3月期	46,064,284株

(参考) 個別業績の概要

1. 2024年3月期の個別業績（2023年4月1日～2024年3月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期	10,927	6.4	7,753	4.8	7,322	4.7	6,689	5.7
2023年3月期	10,271	44.9	7,395	59.7	6,988	86.8	6,330	99.2

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期	142.42	128.89
2023年3月期	137.43	134.95

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期	174,428	82,276	47.2	1,750.10
2023年3月期	119,952	79,406	66.2	1,691.63

(参考) 自己資本 2024年3月期 82,276百万円 2023年3月期 79,365百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料4ページ「1. 経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。

当社は、2024年6月3日に決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）を会場開催及びオンライン（WEB）によるハイブリッド形式での開催を予定しております。決算説明資料については、2024年5月31日に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	4
3. 連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 連結貸借対照表	5
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	7
連結損益計算書	7
連結包括利益計算書	8
(3) 連結株主資本等変動計算書	9
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	11
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	13
(継続企業の前提に関する注記)	13
(会計方針の変更)	13
(表示方法の変更)	13
(セグメント情報)	14
(1株当たり情報)	16
(重要な後発事象)	16

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度における経営環境については、米国景気は良好な雇用・所得環境を背景に個人消費や非製造業の業績が堅調である一方、製造業では在庫等の調整が続くとともに設備投資の低迷が継続しました。米国金利についてはインフレ抑制のための利上げを徐々に抑える方向に向かっています。欧州では、ユーロ圏、英国ともに内需、輸出ともに不振であり、ECBも2023年半ば以降も利上げを止め様子見の状況ですが、年後半から消費者物価指数などは徐々に低下しております。日本は緩やかな景気回復が続き、賃上げなどが進む一方、燃料を中心に輸入品などの価格高騰が継続しております。中国は世界的な需要の低迷から輸出が伸び悩み、内需も特に住宅や不動産の市況悪化などもあり、比較的厳しい経済状況が続いております。政府は金融緩和や財政支出等で下支えをしていますが、景況感としては一進一退の状況です。また、ロシア・ウクライナ間の紛争継続に加え、中東地区での紛争の勃発など、国際紛争に伴う原材料、燃料等の調達ならびに物流等への悪影響は、コスト上昇の一因となっております。

為替相場は、対米ドルレートは期初以降総じて円安方向に進み、期末時点では2000年以降の最も安い水準となっております。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体デバイスの在庫調整局面を迎え需要が低迷、半導体製造装置の需要も欧米製造装置メーカーの発注が前年対比で2ケタの落ち込みとなるなか、中国ローカルメーカーの需要が比較的好調であり、半導体製造装置全体の需要を下支えしました。一方、パワー半導体市場は電気自動車（EV）向けの需要を中心に比較的堅調に推移しました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や受託加工、及び半導体製造プロセス向けの各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）の欧米顧客向けの売上低下を、中国ローカルの半導体製造装置メーカー向け販売の強化、太陽光パネル向け石英坩堝、CVD-SiC製品でカバーし、部門全体で売上を伸ばしました。

電子デバイス事業においては、サーモモジュールはPCR検査装置向けの減少を通信分野の需要でカバーしました。パワー半導体用基板は、IGBTをはじめとする一般産業用途向け、EV向け需要は概ね好調に推移しました。

なお、営業利益は、減価償却費負担増や販売費及び一般管理費の増加もあり、前年同期比で減少しました。経常利益は為替差益1,383百万円の発生が利益を押し上げたものの、前期に発生した為替差益5,495百万円との比較では大きく減少しました。

この結果、当連結会計年度につきましては、売上高は222,430百万円（前期比5.5%増）、営業利益は24,872百万円（前期比29.0%減）、経常利益は26,537百万円（前期比37.5%減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は15,154百万円（前期比49.0%減）となりました。

当連結会計年度のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

当社の真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品や半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）、部品洗浄サービスは、半導体の設備投資需要の停滞及び設備稼働率の低下に加えて、マテリアル製品等の在庫調整の影響で売上が減少しましたが、中国ローカルの装置メーカーの需要を取り込み、欧米メーカーの売上減少をカバーしました。石英坩堝は太陽光パネル製造メーカー向けの大型坩堝製品が大幅に売上を伸ばしました。また、マテリアル製品のうち需要に対し供給能力が不足するCVD-SiC製品では生産能力の増強もあり、引続き売上を伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は130,072百万円（前期比1.6%減）、営業利益は16,260百万円（前期比32.5%減）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

サーモモジュールは、PCR検査装置用途が大きく減少しましたが、通信分野向け、特に生成AI関連で注目される大容量の光トランシーバー向けが伸びたことで減少をカバーし、全体では増収となりました。パワー半導体用基板は、DCB基板が産業機械向けなどで売上を伸ばし、AMB基板も中国EV車向けで堅調に推移し、全体でも大きく売上を伸ばしました。また、センサは前第2四半期連結会計期間より株式会社大泉製作所を連結化したため、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

この結果、当該事業の売上高は67,600百万円（前期比27.5%増）、営業利益は10,890百万円（前期比2.6%減）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械は前年同期比で出荷が減少しました。また、ソーブレードには前第2四半期連結会計期間より連結化した東洋刃物株式会社の売上、利益が前第3四半期連結会計期間より含み、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

この結果、当該事業の売上高は24,757百万円（前期比3.3%減）、営業損失は1,197百万円（前期は597百万円の営業利益）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末と比べ99,378百万円増加し、510,026百万円となりました。これは主に現金及び預金14,139百万円、受取手形、売掛金及び契約資産8,663百万円、有形固定資産61,729百万円の増加によるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べ70,869百万円増加し、231,860百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金2,189百万円、社債（1年内償還予定を含む）4,723百万円が減少したものの、短期借入金6,076百万円、転換社債型新株予約権付社債25,000百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）42,088百万円増加によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比べ28,509百万円増加し、278,166百万円となりました。これは主に利益剰余金10,224百万円、為替換算調整勘定8,838百万円、非支配株主持分7,869百万円の増加によるものであります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ901百万円増加し、96,806百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は28,720百万円（前連結会計年度比14,303百万円減）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益26,146百万円、減価償却費16,398百万円によるものであります。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額5,177百万円、売上債権の増加額4,919百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は92,400百万円（前連結会計年度比23,639百万円増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出74,489百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は60,419百万円（前連結会計年度比8,299百万円減）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出16,860百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5,897百万円の一方、長期借入れによる収入57,734百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入24,898百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
自己資本比率 (%)	25.5	37.8	49.5	44.7	40.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	10.8	46.3	46.3	37.9	27.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	8.8	3.6	2.1	1.6	4.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	9.6	9.2	21.9	44.3	15.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち短期借入金、社債（1年内償還予定を含む）、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金（1年内返済予定を含む）を対象としております。

(4) 今後の見通し

当社の2025年3月期の連結業績の見通しについては、売上高は235,000百万円、営業利益は26,000百万円、経常利益は26,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は16,000百万円としております。為替レートは、1ドル150円を前提としています。

全般的な経営環境に対する見方については、半導体業界では2023年まで継続したデバイスの在庫調整局面から徐々に需要回復が見込まれ、特にロジック半導体分野では生成AIに欠かせないGPUの需要増、サーバー投資の増加などが期待され、メモリ関連も直近価格の改善がみられ、年後半からは工場稼働率改善、設備投資水準回復へとつながると期待されます。移動通信システム業界については、5Gネットワーク投資が継続するほか、サーバー向けの大容量光トランシーバー需要も大きく伸びると見ており、総じて堅調な需要状況となる見通しです。自動車関連もEV、自動運転システムなどの需要が伸びると見込んでおります。地政学的見地では、半導体先端技術に関する米中規制の強化は、半導体各社の中国外への製造拠点移転を促しましたが、その大きな受け皿となる東南アジア地区での各社製造能力整備が進んでおり、同地区での需要増が期待されます。一方、原材料調達の面では、ロシアのウクライナ侵攻および中東での紛争継続もあり、材料価格高騰、物流混乱による調達ひっ迫などの悪影響が予想されます。

そうした環境のなか、半導体等装置関連事業については、真空シール及び金属受託加工については日米欧製造装置メーカー及び中国ローカルメーカーの設備投資の回復により需要増加を見込み、半導体製造用のマテリアル製品（石英・セラミックス・シリコンパーツ等）についても、在庫調整の影響から製品により時期は異なるものの、需要は回復基調にあると考えています。また、年後半にはマレーシア製造拠点の稼働が本格化する見込みです。部品洗浄事業も工場稼働率の回復に伴い売上を伸ばす見込みです。石英坩堝は太陽光発電向け及び半導体向けの需要を取り込み、増収を目指します。

電子デバイス事業については、サーモモジュールは、需要は底堅い移動通信機器分野向け及び生成AIで注目される大容量通信タイプの光トランシーバー向けの拡販を見込んでおり、また応用製品であるチラーの拡販策を進めていく予定です。パワー半導体用基板は省電力ニーズの高まりを背景として産業機器、民生機器向けの需要は伸長する見込みであり、加えて中国EV車向けの量産、及び他地域のEV車への採用等で本年も大きく成長できるものと見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	103,115	117,254
受取手形、売掛金及び契約資産	53,276	61,940
商品及び製品	12,059	18,092
仕掛品	13,505	12,875
原材料及び貯蔵品	23,613	25,942
その他	9,955	12,615
貸倒引当金	△184	△312
流動資産合計	215,341	248,408
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	56,815	88,714
減価償却累計額	△18,735	△22,130
建物及び構築物(純額)	38,080	66,583
機械装置及び運搬具	79,214	102,818
減価償却累計額	△35,042	△43,285
機械装置及び運搬具(純額)	44,171	59,533
工具、器具及び備品	21,236	24,853
減価償却累計額	△15,252	△17,384
工具、器具及び備品(純額)	5,984	7,468
土地	4,451	4,660
リース資産	13,236	14,955
減価償却累計額	△2,227	△2,937
リース資産(純額)	11,009	12,018
建設仮勘定	35,913	51,075
有形固定資産合計	139,610	201,339
無形固定資産		
のれん	2,304	2,010
その他	4,645	4,600
無形固定資産合計	6,949	6,611
投資その他の資産		
投資有価証券	5,508	8,420
関係会社株式	33,893	32,944
繰延税金資産	2,130	2,696
その他	7,850	10,304
貸倒引当金	△636	△699
投資その他の資産合計	48,745	53,666
固定資産合計	195,306	261,618
資産合計	410,648	510,026

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	40,524	38,334
電子記録債務	3,372	3,967
短期借入金	20,378	26,454
1年内償還予定の社債	4,723	3,763
1年内返済予定の長期借入金	11,102	17,259
リース債務	701	1,030
未払法人税等	2,432	2,128
賞与引当金	2,913	3,549
設備関係未払金	11,541	10,227
その他	13,604	15,432
流動負債合計	111,294	122,148
固定負債		
社債	4,083	320
転換社債型新株予約権付社債	—	25,000
長期借入金	26,432	62,364
リース債務	4,843	4,659
繰延税金負債	4,908	5,878
退職給付に係る負債	2,020	1,802
資産除去債務	348	402
その他	7,060	9,283
固定負債合計	49,697	109,712
負債合計	160,991	231,860
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,425	29,539
資本剰余金	67,961	68,305
利益剰余金	69,656	79,881
自己株式	△88	△89
株主資本合計	166,955	177,638
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	272	1,254
為替換算調整勘定	16,477	25,316
退職給付に係る調整累計額	23	200
その他の包括利益累計額合計	16,773	26,771
新株予約権	40	—
非支配株主持分	65,887	73,756
純資産合計	249,656	278,166
負債純資産合計	410,648	510,026

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高	210,810	222,430
売上原価	138,728	152,573
売上総利益	72,081	69,856
販売費及び一般管理費	37,038	44,984
営業利益	35,042	24,872
営業外収益		
受取利息	574	2,018
受取配当金	28	29
賃貸収入	16	16
為替差益	5,495	1,383
補助金収入	2,626	3,482
その他	1,132	1,072
営業外収益合計	9,872	8,002
営業外費用		
支払利息	1,136	1,786
支払手数料	84	152
持分法による投資損失	610	3,742
その他	636	655
営業外費用合計	2,466	6,337
経常利益	42,448	26,537
特別利益		
投資有価証券売却益	—	23
持分変動利益	651	710
段階取得に係る差益	204	—
その他	—	20
特別利益合計	856	754
特別損失		
固定資産処分損	226	206
投資有価証券評価損	—	515
減損損失	—	424
災害による損失	334	—
段階取得に係る差損	702	—
特別損失合計	1,263	1,145
税金等調整前当期純利益	42,041	26,146
法人税、住民税及び事業税	6,973	5,432
法人税等調整額	780	77
法人税等合計	7,753	5,510
当期純利益	34,288	20,635
非支配株主に帰属する当期純利益	4,585	5,481
親会社株主に帰属する当期純利益	29,702	15,154

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益	34,288	20,635
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△130	982
為替換算調整勘定	3,027	10,120
退職給付に係る調整額	99	177
持分法適用会社に対する持分相当額	1,563	1,784
その他の包括利益合計	4,559	13,063
包括利益	38,847	33,699
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	32,964	25,212
非支配株主に係る包括利益	5,882	8,486

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	28,210	46,071	43,317	△87	117,511
当期変動額					
新株の発行	148	148			296
転換社債型新株予約権付社債の転換	1,067	1,067			2,134
剰余金の配当			△3,545		△3,545
親会社株主に帰属する当期純利益			29,702		29,702
連結範囲の変動			181		181
連結子会社の増資による持分の増減		20,674			20,674
自己株式の取得				△1	△1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	1,215	21,890	26,339	△1	49,443
当期末残高	29,425	67,961	69,656	△88	166,955

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	406	13,128	△23	13,511	45	29,888	160,957
当期変動額							
新株の発行							296
転換社債型新株予約権付社債の転換							2,134
剰余金の配当							△3,545
親会社株主に帰属する当期純利益							29,702
連結範囲の変動							181
連結子会社の増資による持分の増減							20,674
自己株式の取得							△1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△134	3,349	46	3,262	△5	35,998	39,255
当期変動額合計	△134	3,349	46	3,262	△5	35,998	88,699
当期末残高	272	16,477	23	16,773	40	65,887	249,656

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	29,425	67,961	69,656	△88	166,955
当期変動額					
新株の発行	114	114			228
剰余金の配当			△4,929		△4,929
親会社株主に帰属する 当期純利益			15,154		15,154
連結子会社の増資による 持分の増減		3,466			3,466
非支配株主との取引に係る 親会社の持分変動		△3,237			△3,237
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	114	343	10,224	△0	10,682
当期末残高	29,539	68,305	79,881	△89	177,638

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	為替換算調整 勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包 括利益累計 額合計			
当期首残高	272	16,477	23	16,773	40	65,887	249,656
当期変動額							
新株の発行							228
剰余金の配当							△4,929
親会社株主に帰属する 当期純利益							15,154
連結子会社の増資による 持分の増減							3,466
非支配株主との取引に係る 親会社の持分変動							△3,237
自己株式の取得							△0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	982	8,838	177	9,997	△40	7,869	17,826
当期変動額合計	982	8,838	177	9,997	△40	7,869	28,509
当期末残高	1,254	25,316	200	26,771	—	73,756	278,166

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	42,041	26,146
減価償却費	12,618	16,398
減損損失	—	424
のれん償却額	185	264
株式報酬費用	438	375
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	—	△81
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,140	483
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△388	158
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	27	△227
受取利息及び受取配当金	△602	△2,048
支払利息	1,136	1,786
為替差損益 (△は益)	△1,402	△798
持分法による投資損益 (△は益)	610	3,742
固定資産処分損	226	206
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	515
持分変動損益 (△は益)	△651	△710
段階取得に係る差損益 (△は益)	498	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,139	△4,919
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△14,354	△5,177
その他の資産の増減額 (△は増加)	3,033	△1,554
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,516	△4,472
持分法適用会社からの前受金の増減額 (△は減少)	△493	—
その他の負債の増減額 (△は減少)	2,402	3,472
その他	568	426
小計	50,411	34,410
利息及び配当金の受取額	588	2,131
利息の支払額	△971	△1,852
法人税等の支払額	△7,003	△5,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,024	28,720

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△7,029	△14,065
有形固定資産の取得による支出	△56,001	△74,489
有形固定資産の売却による収入	236	259
無形固定資産の取得による支出	△976	△737
投資有価証券の取得による支出	△4,607	△2,098
投資有価証券の売却による収入	—	34
関係会社株式の取得による支出	△849	△282
関係会社出資金の払込による支出	—	△97
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△379
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	557	—
貸付けによる支出	—	△67
貸付金の回収による収入	4	14
その他投資活動による収入	130	22
その他投資活動による支出	△226	△514
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,760	△92,400
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	11,687	5,314
長期借入れによる収入	24,256	57,734
長期借入金の返済による支出	△8,311	△16,860
リース債務の返済による支出	△339	△95
社債の償還による支出	△2,658	△4,723
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	—	24,898
株式の発行による収入	11	39
自己株式の取得による支出	△1	△0
非支配株主からの払込みによる収入	47,607	5,183
配当金の支払額	△3,532	△4,925
非支配株主への配当金の支払額	—	△303
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1	△5,897
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	—	54
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,718	60,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	344	4,162
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	43,326	901
現金及び現金同等物の期首残高	52,579	95,905
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△0	—
現金及び現金同等物の期末残高	95,905	96,806

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社では、取扱い製品を製品用途の類似性と販売先業種により区分し、「半導体等装置関連事業」、及び「電子デバイス事業」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体等装置関連事業」は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、C V D－S i C製品、シリコンパーツ、石英坩堝等の生産、並びに装置部品洗浄等を行っております。

「電子デバイス事業」は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサ等を生産しております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

なお、当社では事業セグメントへの資産の配分は行っておりません。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額(注) 3
	半導体等 装置関連事業	電子デバイス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	132,194	53,024	185,219	25,590	210,810	—	210,810
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	132,194	53,024	185,219	25,590	210,810	—	210,810
セグメント利益	24,090	11,178	35,269	597	35,866	△824	35,042
その他の項目							
減価償却費	9,778	2,078	11,857	749	12,607	10	12,618
のれんの償却額	36	149	185	—	185	—	185

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△824百万円には、セグメント間取引の消去96百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用727百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額(注) 3
	半導体等 装置関連事業	電子デバイス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	130,072	67,600	197,672	24,757	222,430	—	222,430
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	130,072	67,600	197,672	24,757	222,430	—	222,430
セグメント利益又は 損失(△)	16,260	10,890	27,150	△1,197	25,953	△1,080	24,872
その他の項目							
減価償却費	12,363	2,979	15,342	1,038	16,381	16	16,398
のれんの償却額	78	185	264	—	264	—	264

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,080百万円には、セグメント間取引の消去841百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用239百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	3,916.07円	4,348.01円
1株当たり当期純利益	644.81円	322.65円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	633.15円	291.99円

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	29,702	15,154
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益(百万円)	29,702	15,154
期中平均株式数(千株)	46,064	46,968
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整 額(百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	848	4,931
(うち転換社債型新株予約権付社債 (千株))	(768)	(4,886)
(うち新株予約権(千株))	(79)	(45)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり当期純利益の算定に含めなか った潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

該当事項はありません。